

NC254 免洗焊膏

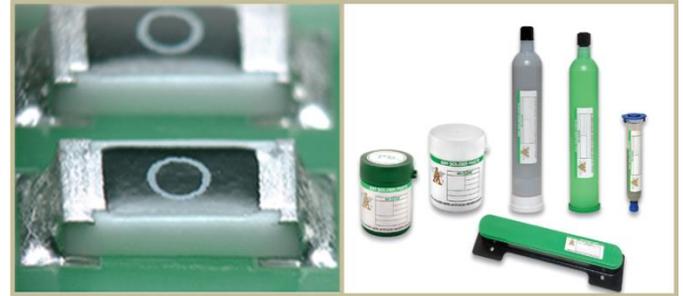
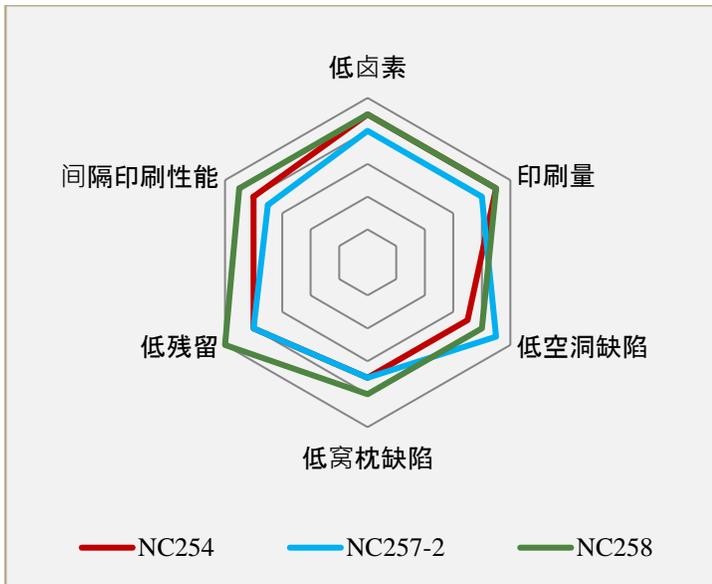
特性

- 工艺窗口宽
- 残留物透明，探针可测
- 无卤化物
- 优秀的润湿性，可润湿无引脚组件
- 减少 Micro-BGAs 下的空洞缺陷
- 钢网停留寿命为 24 小时
- 黏附持续 12-14 小时

描述

NC254 有着极其宽的印刷、润湿和针测工艺窗口，NC254 极佳的润湿性能使焊点表面光滑闪亮。NC254 即使在今天无铅合金要求相对高的温度条件下，它仍具有非常低的焊后残留，其尚存的透明残留物易被针刺穿。NC254 可降低或消除 Micro-BGAs 下的空洞。NC254 还可用于防塌落和耐潮，延长焊膏在环境控制不佳的设施中的使用寿命。

特点



处理及储存

合金	参数	时间	温度
无铅	冷藏保质期	9 个月	0°C-12°C (32°F-55°F)
无铅	非冷藏保质期	4 个月	< 25°C (< 77°F)
含铅	冷藏保质期	12 个月	0°C-12°C (32°F-55°F)
含铅	非冷藏保质期	无	无

请勿将使用过的焊膏添加到未使用过的锡膏中。使用过的锡膏要与未使用过的锡膏分开储存；对未使用的锡膏，要将内盖或顶盖盖好并重新密封。详情请见 AIM 焊膏使用指导。合金的成分和贮存条件可能会影响保质期。请参阅 NC254 分析证书中的特定信息。

清洁

回流前：在进程中，AIM DJAW-10 可将 NC254 有效地从钢网上清除。可手工将 DJAW-10 应用在钢网擦拭设备上。DJAW-10 不会让 NC254 变干并且会加强传输性能。请勿过量使用 DJAW-10。不要把 DJAW-10 涂于钢网顶部。不推荐在工艺过程中使用异丙醇 (IPA)，但可用于最后钢网清洗。

回流焊后残留：NC254 可能会在回流后有残留存在存在组件上，无需清洗。若有要求清洗，AIM 已与行业伙伴合作确保 NC254 残留可用普通助焊残留清洗剂清洗。请联系 AIM 获得清洁兼容性信息。

回流曲线图

请访问 <http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>. 获得详细的回流曲线信息。联系 AIM 以获得更多信息。

打印

以下推荐的印刷机初始设定取决于 PCB 和 PAD 设计	
参数	推荐初始设定
刮刀压力	0.10 -0.30 公斤/厘米 (.6 -1.7 磅/英寸.) 每刀片
刮刀速度	25-50 毫米/秒(1-2 英寸/秒)
接触距离	接触 0.00 毫米 (0.00'')
PCB 分离距离	0.75 - 2.0 毫米
PCB 分离速度	慢

测试数据小结

名称	测试方法	结果	
IPC 分类	J-STD-004	ROLO	
名称	测试方法	典型结果	图像
铜镜	J-STD-004 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	低	
腐蚀性	J-STD-004 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	通过	
定量卤化物、铬酸银测试	J-STD-004 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	通过	
定量卤化物、氟化点	J-STD-004 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	无氟化物	
表面绝缘电阻	J-STD-004 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.3	通过	可按需提供报告
电化迁移	J-STD-004 3.4.1.5 IPC-TM-650 2.6.14.1 GR-78-CORE	通过	可按需提供报告
助焊剂固体含量、非挥发性测定	J-STD-004 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	96.7% 典型	
酸值测定	J-STD-004 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	114 mg KOH/g 助焊剂 典型	

名称	测试方法	典型结果	图像
粘度	J-STD-004 3.4.2.4 IPC-TM-650 2.4.34	300-900 Kcps	
外观	J-STD-004 3.4.2.5	灰色光滑的膏状	
坍塌测试	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	通过	
锡球测试	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	通过	
粘性	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	34.2 gf 典型	